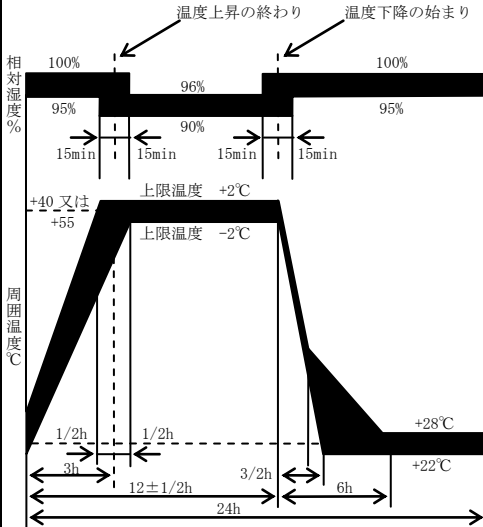


適用規格		SD Card Specifications Ver 1.0					
定 格	使用温度範囲	－ 2 5℃ ～ ＋ 8 5℃（注 1）		保存温度範囲	－ 4 0℃ ～ ＋ 8 5℃		
	電 圧	A C 1 2 5 V		使用湿度範囲	相対湿度 9 5 % 以下 （ただし、結露しないこと。）		
	電 流	0 . 5 A					
性 能							
	項 目	試 験 方 法		規 格	QT	AT	
構造	外観・構造・仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。		図面と合致していること。	○	○	
	表 示	目視にて確認する。			○	○	
電 氣 的 性 能	低電圧、低電流下の接触抵抗 IEC60512-2-2a	開放電圧20 mV、試験電流1 mA で測定する。		100mΩ以下（初期値）。（注 2）	○	－	
	耐 電 圧 IEC60512-2-4a	AC 500Vrmsの電圧を 1 分間印加する。		①せん絡・絶縁破壊がないこと。 ②漏洩電流 1 mA以下。	○	－	
	絶 縁 抵 抗 IEC60512-2-3a	DC 500Vの電圧を印可し1分以内に測定する。		1000MΩ以上（初期値）。	○	－	
機 械 的 性 能	カード挿入操作力	スピート25mm/minにて適合カードで測定する。		初期：10N以下。挿抜寿命後：12N以下。	○	－	
	カード引抜操作力			初期：10N以下。挿抜寿命後：12N以下。	○	－	
	挿抜寿命 （オフィス環境） EIA364b class1.1	毎時 400～600回の速度で、10,000回の挿抜を行う。		①接触抵抗：初期からの変化量 40mΩ以下。 （挿抜により接触抵抗値が復帰すれば可。） ②極度の摩耗や破損等の異常がないこと。	○	－	
	振動・高周波 IEC60512-4-6d	片振幅0.75mm、周波数10～55～10Hzの振動を X、Y、Z軸3方向各2時間加える。		①100ns以上の瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	－	
	衝 撃 IEC60512-4-6c	加加速度490m/s ² 、持続時間11msの正弦半波で 3方向各3回の衝撃を加える。		①100ns以上の瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	－	
環 境 的 性 能	温湿度サイクル IEC60512-6-11m	1サイクル 24時間で 10サイクルの嵌合放置をする。 		①接触抵抗：初期からの変化量 40mΩ以下。 ②絶縁抵抗：100MΩ以上。 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。		○	－
△の数		訂正記事		設計	検図	年月日	
△							
備考（注 1）通電による温度上昇を含む。 （注 2）接触抵抗は導体抵抗を含む。 規定無き場合は温度15℃～35℃、気圧86～106kPa、湿度25～85%の試験環境下にて実施のこと。				承認	HT. YAMAGUCHI	20200318	
				検 図	HT. YAMAGUCHI	20200318	
				担 当	MT. ITANO	20200318	
				製 図	DS. HIROWATARI	20200317	
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目				図番	SLC-153563-92-00		
HRS	製 品 規 格 表		製品名	DM1B-DSF-PEJ (92)			
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL609-0003-5-92			
				△	1/2		

性能						
項 目		試 験 方 法	規 格	QT	AT	
環 境 的 性 能	熱 衝 撃 IEC60512-6-11d	温度 -55～ +85℃、変化時間 5分以内で 5サイクル（1サイクル=1h）の嵌合放置をする。	①接触抵抗：初期からの変化量 40mΩ以下 ②絶縁抵抗：100MΩ以上 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○	—	
	耐 熱 性 IEC60512-6-11i	温度 +85℃に 96hの嵌合放置をする。	①接触抵抗：初期からの変化量 40mΩ以下 ②絶縁抵抗：100MΩ以上 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○	—	
	耐 寒 性 IEC60512-6-11j	温度 -25℃に 96hの嵌合放置をする。	①接触抵抗：初期からの変化量 40mΩ以下 ②絶縁抵抗：100MΩ以上 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○	—	
	耐 湿 （定常状態） IEC60512-6-11c	温度+40℃、湿度 90～95%RH中に96hの嵌合放 置をする。	①接触抵抗：初期からの変化量 40mΩ以下 ②絶縁抵抗：100MΩ以上 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○	—	
	硫化水素ガス JEIDA 38	温度+40℃、湿度80%RH、H ₂ S 3ppmのガス中に 96hの嵌合放置をする。	①接触抵抗：初期からの変化量 40mΩ以下 ②絶縁抵抗：100MΩ以上 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○	—	
	塩 水 噴 霧 JIS C 5402 7.1	温度35±2℃、5±1%の塩水噴霧中に48時間の 嵌合放置をする。（後処理：塩の付着物を水洗 い後、室温に24時間放置）	①機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○	—	
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC-153563-92-00		
HRS	製 品 規 格 表		製品名	DM1B-DSF-PEJ (92)		
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL609-0003-5-92	△	2/2